软盘编号
CAD
会签
描图
描校
旧底图登记号
底图登记号

P1	介绍
P2	框图
P3	核心板
P4	ADDA数字隔离
P5	触发_DA
P6	AD供电
P7	AD采集
P8	IO
P9	CAN/RS422/485/232
P10	CONNECT
P11	USB
P12	JTAG_LED_BOOT
P13	ETHERCAT
P14	I2C
P15	系统供电

层数	6层
层	名称
1	TOP
2	POWER
3	内层3
4	内层 4
5	GND
6	воттом

					SOC						
					图号	14Y	'F001				仪器
					图名	14Y	'F001	_底板	•		
标记	更改单号		签字、	日期	板材	FR4	-				
设计		会签			板厚	1.6m	nm	铜厚	35um		
校对						阶县	设标证	1	版本	图纸	
审核		标审					S		A.2	A3	
工艺		批准					共 1	.5 页 第	5 1页		

仪器平台

北京中盛华旭 电子科技有限公司

VSUNTEK



CAD

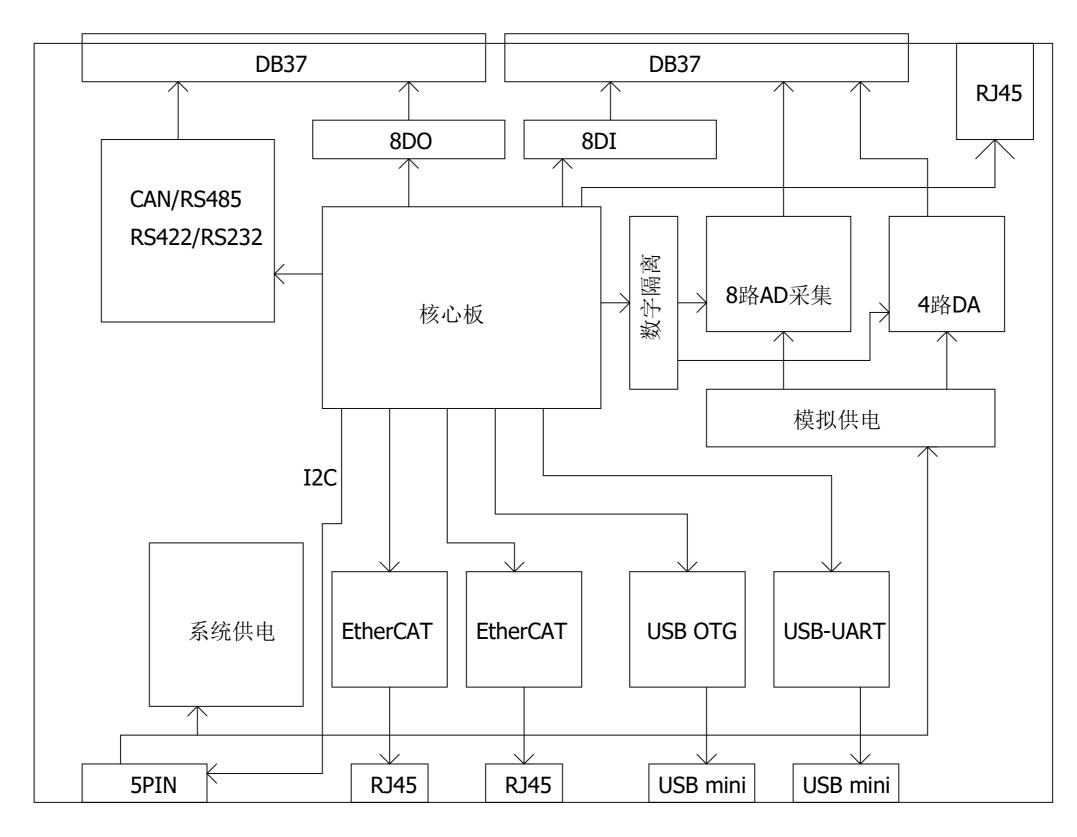
会签

描图

描校

旧底图登记号

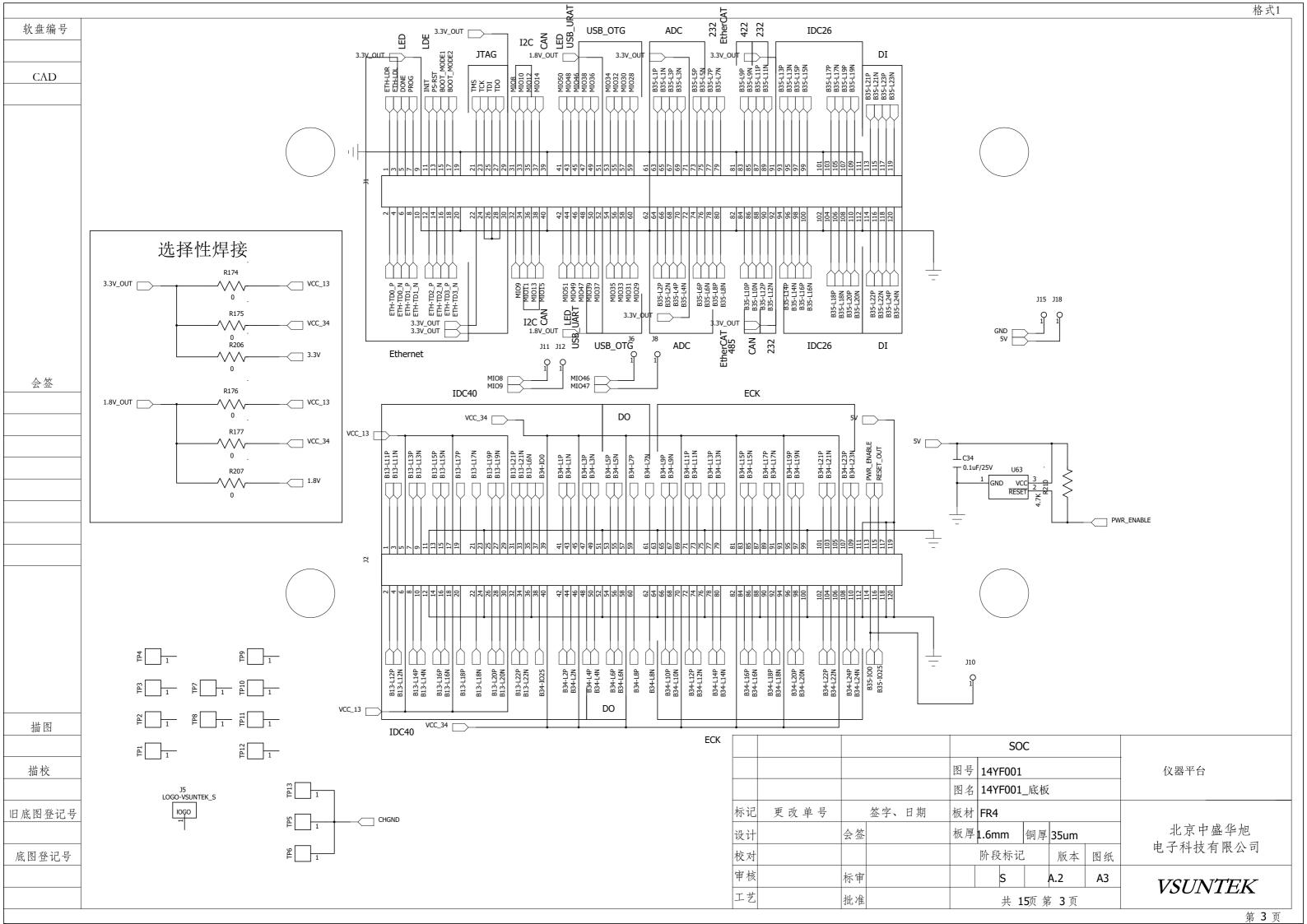
底图登记号



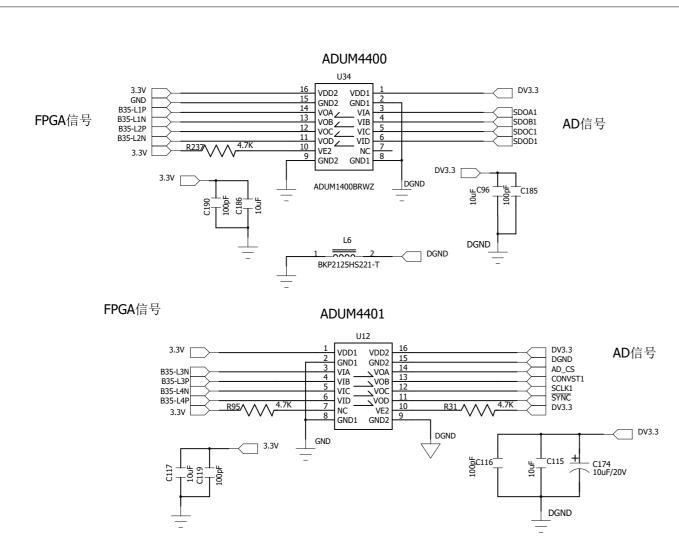
					SOC						
					图号	14	F00	1			仪器平台
					图名	14	F00	1_底	板		
标记	上 更改单号		签字、	日期	板材	FR4					
设计	-	会签			板厚	1. 6r	nm	铜厚	35um		1
校对	-					阶段	标记	1	版本	图纸	电子
审核	{	标审					S		A. 2	A3	VS
工艺	٠	批准					共 1	5页 第	5 2 页		V

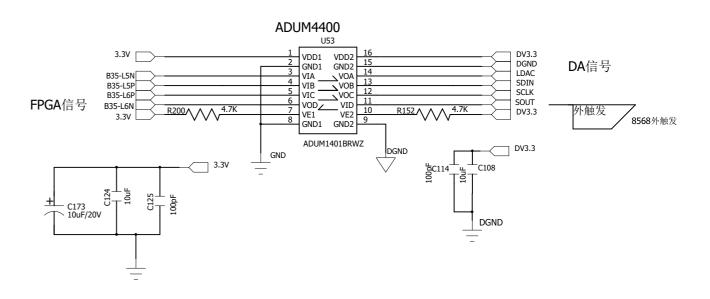
北京中盛华旭 电子科技有限公司

VSUNTEK

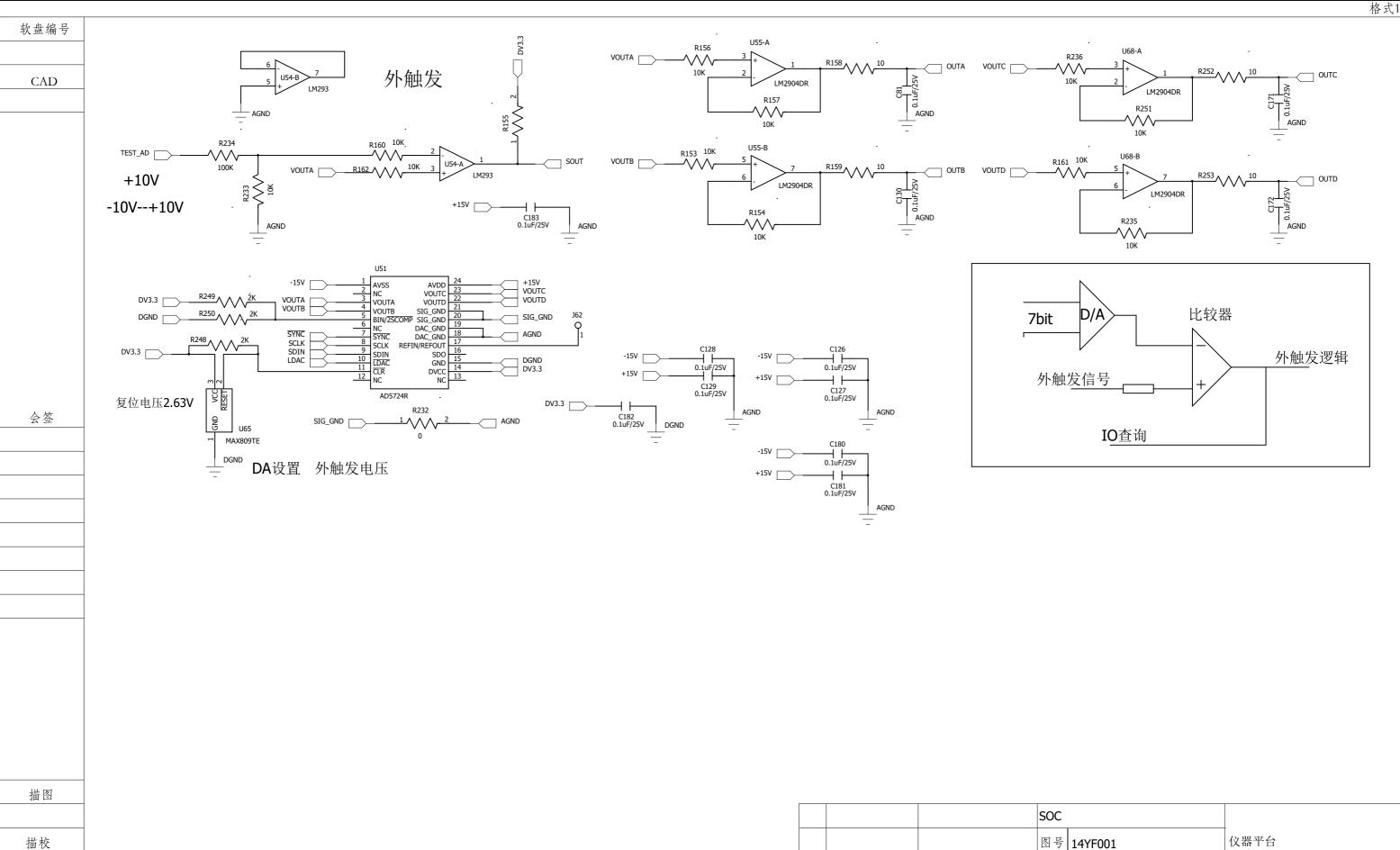


软盘编号 CAD 会签 描图 描校 旧底图登记号 底图登记号





				SOC						仪器平台	
				图号	14Y	F001					
				图名	14Y	F001	_底板	-			
标记	更改单号		签字、日期	板材	FR4						
设计		会签		板厚	1.6m	ım	铜厚	35um		北京中盛华旭	
校对					阶段	标记	!	版本	图纸	电子科技有限公司	
审核		标审				S		A.2	A3	VSUNTEK	
工艺		批准				共 1	5 页 第	5 4 页		VSUIVIEA	



旧底图登记号

底图登记号

					SOC						
					图号	图号 14YF001					仪器平台
					图名	14YI	F001_	_底板			
标记	更改单号		签字、	日期	板材	FR4					
设计		会签			板厚	1.6m	m	铜厚	35um		北京中盛华旭
校对						阶段	标记		版本	图纸	电子科技有限公司
审核		标审					S		A. 2	А3	VCI INTTEV
工艺		批准				共 15页 第 5 页				VSUNTEK	

第 5 页

软盘编号

CAD

会签

U57焊接时R258不焊接 U57不焊接时R258焊接 R258 输出15V **^** 输出**14V** +17V +15V_A U57 XC6202PC0MR 输出14V \mathcal{M} IN 8 OUT +L C158 \sim C165 + C163 T 0.1uF T 1uF/35V C169 + C167 T 0.1uF T 1uF/35V VIN V+ 3 0V 5 GND NC AGND_A \mathcal{M} SGND ___ R203 2K WRA2415LT-3W 1 C166 + C164 T 0.1uF 1uF/35V C170 + C168 T 0.1uF 1uF/35V **^** _ C162 - 0.1uF C161 47uF + C160 4.7uF/ ` 4.7uF/25V T R181 N DS8 L5 M -15V 10uH XC6902NC01MR -15V_A 输出-14V -17V R259 输出-14V **-**输出-15V 47uF U58焊接时R259不焊接 U58不焊接时R259焊接 U62 VIN +VO ⊥ C177 U64 0.1uF 土 C176 1uF/35V F2405XT-1WR2 ~_ C84 _____10uF 0.1uF/25V DGND BKP2125HS221-T

描图

描校

旧底图登记号

底图登记号

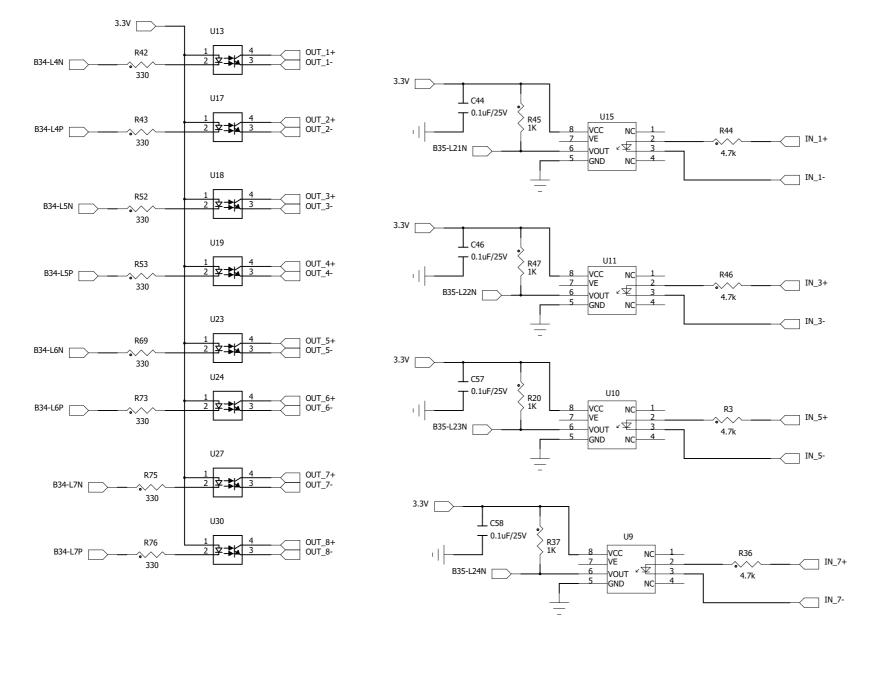
SOC 图号 14YF001 图名 14YF001_底板 标记 更改单号 签字、日期 板材 FR4 板厚**1.6mm** 设计 会签 铜厚 35um 校对 版本 图纸 阶段标记 审核 标审 А3 共 15页 第 6 页

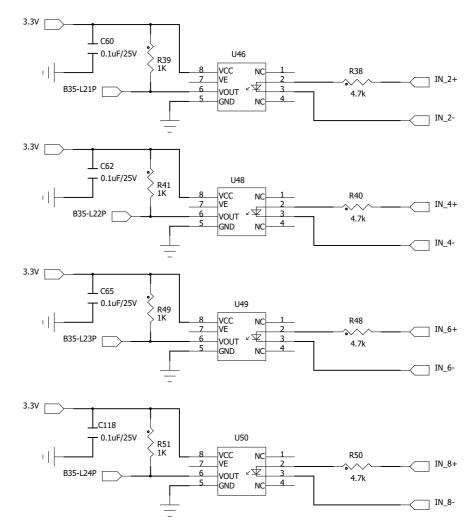
仪器平台

北京中盛华旭 电子科技有限公司

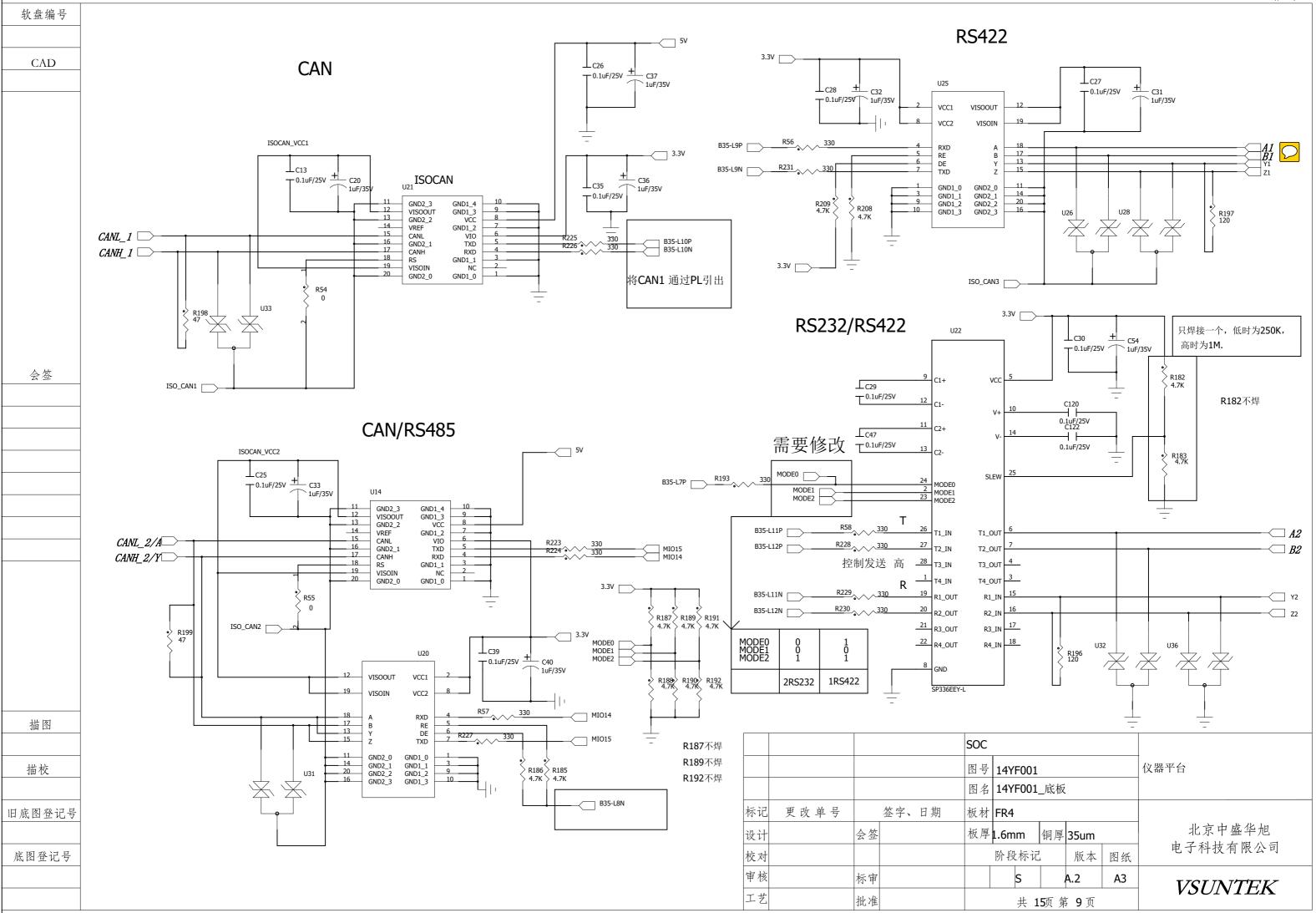
VSUNTEK

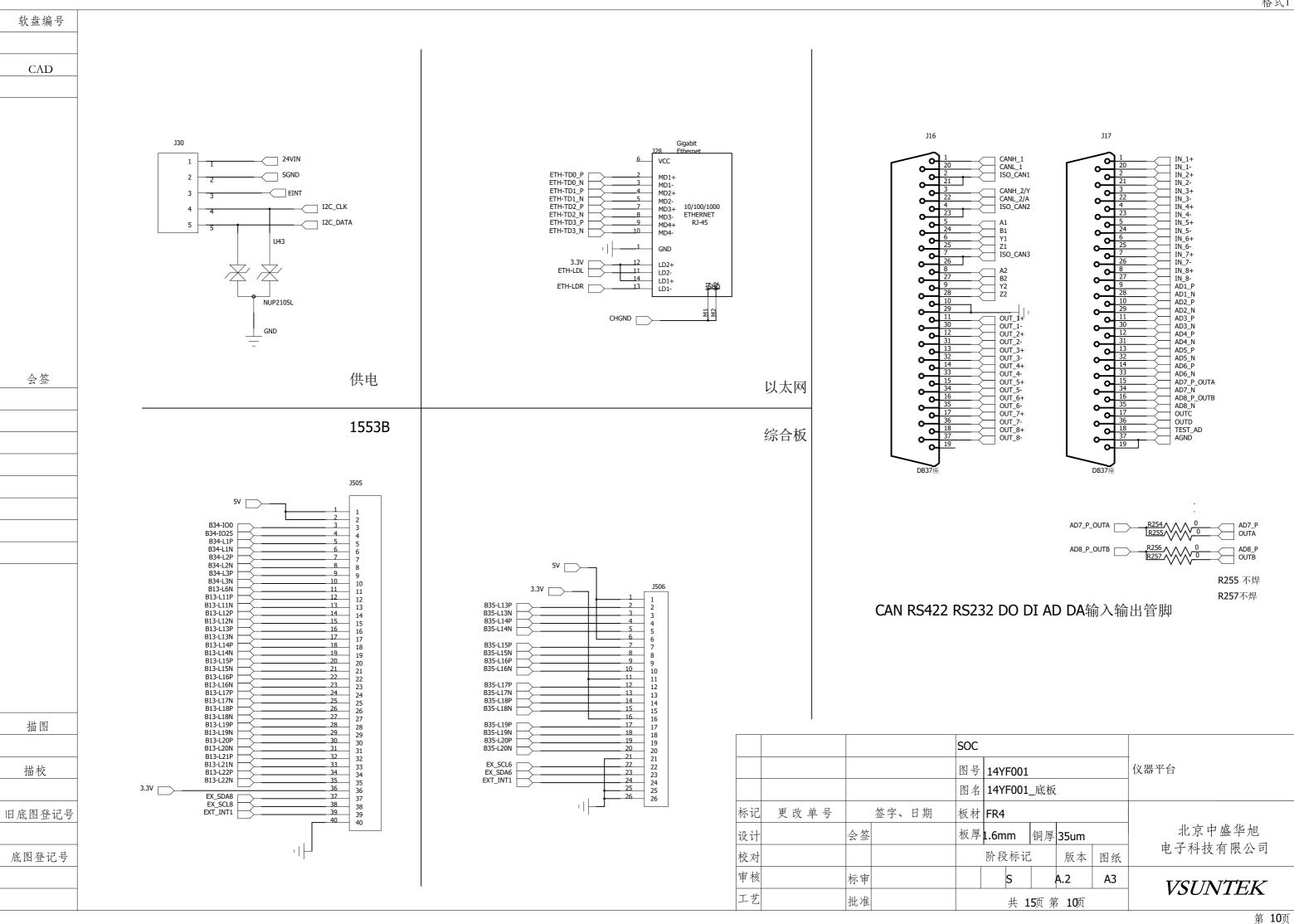


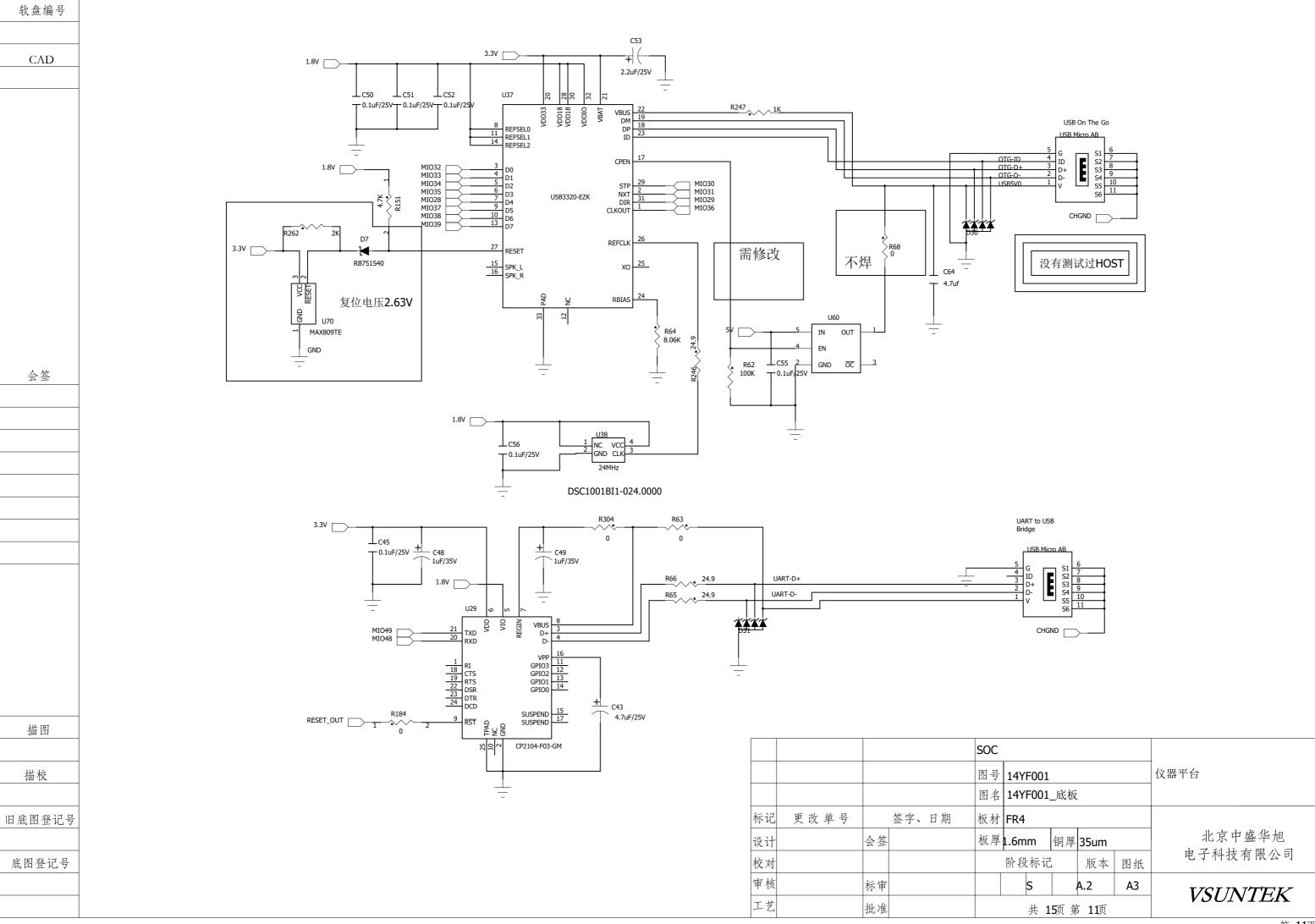




					SOC							
					图号	14YF	F001				仪器平台	
					图名	14YF	F001	_底板	į			
标记	更改单号		签字、	日期	板材	FR4						
设计		会签			板厚	1.6m	m	铜厚	35um		北京中盛华旭	
校对						阶段	标记	!	版本	图纸	电子科技有限公司	
审核		标审					S		A.2	А3	VCIINITEV	
工艺		批准					共 1	.5 页 第	5 8页		VSUNTEK	



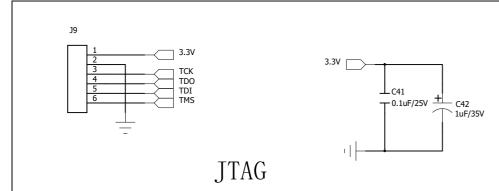


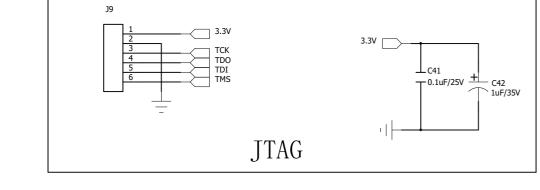


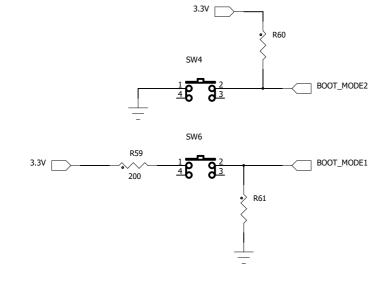


CAD

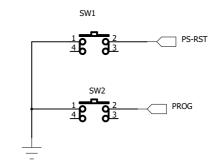
会签

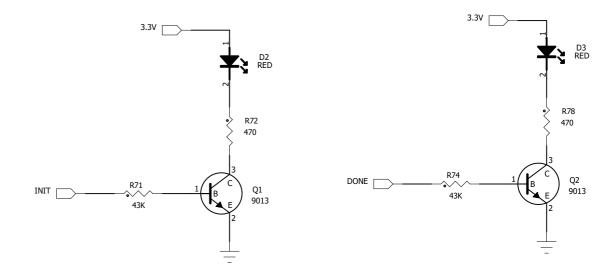


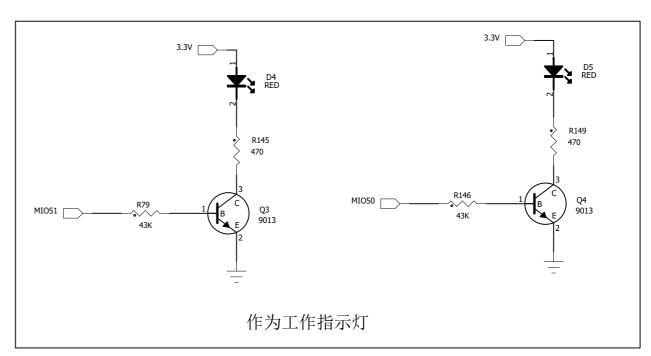




BOOTMODE2	BOOTMODE1	BOOT
0	0	JTAG
1	0	Quad-SPI
1	1	SDIO
0	1	NAND
		l I







						SOC						
仪				F001	14Y	图号						
		-	_底板	F001	14Y	图名						
					FR4	板材	日期	签字、		单号	更改	标记
		35um	铜厚	ım	1.6m	板厚			会签			设计
	图纸	版本		标记	阶段							校对
	А3	A.2		S					标审			审核
		· 12页	5页 耸	土 1					批准			工艺

义器平台

北京中盛华旭 电子科技有限公司

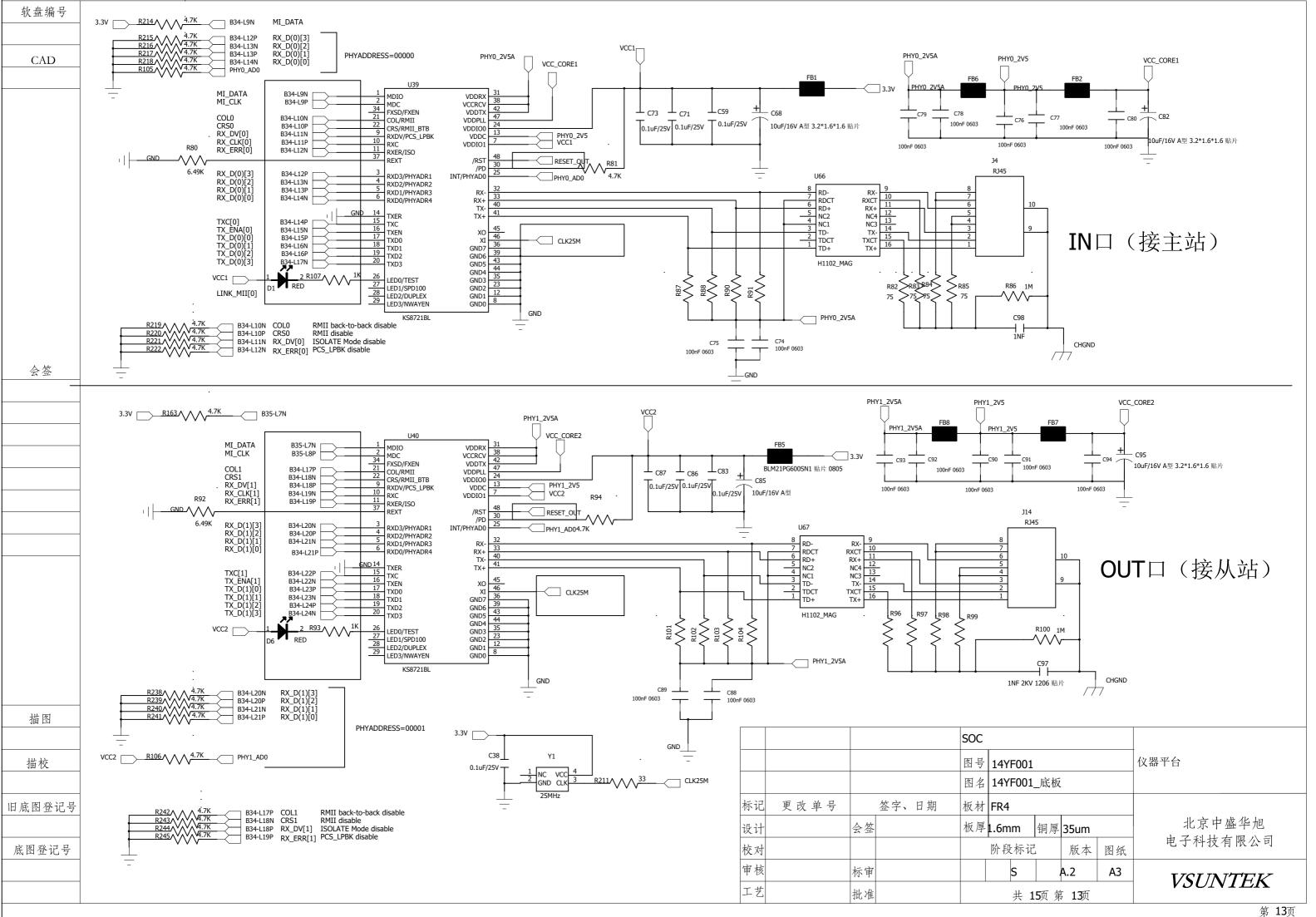
VSUNTEK

描图

描校

旧底图登记号

底图登记号



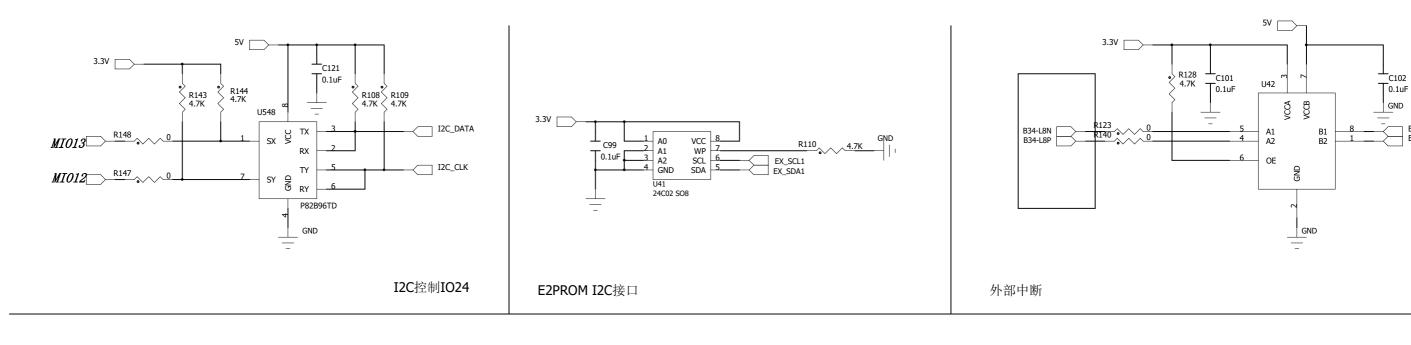


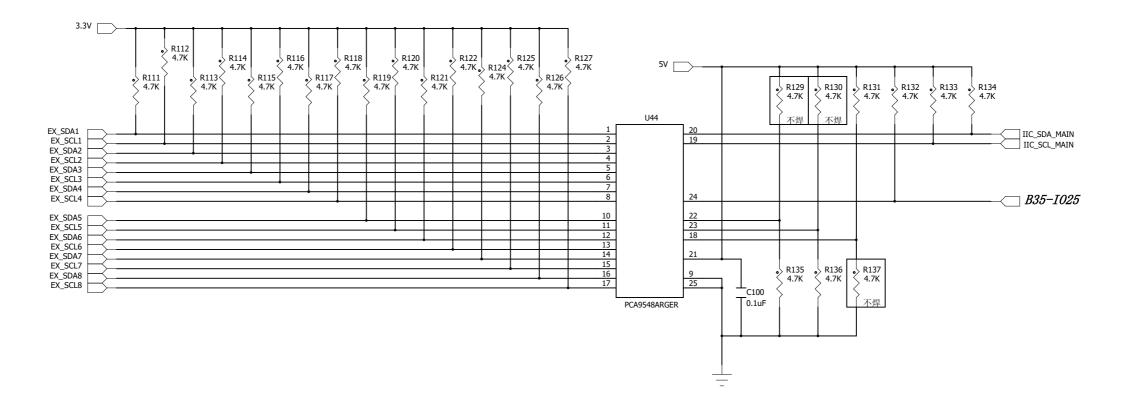
描图

描校

旧底图登记号

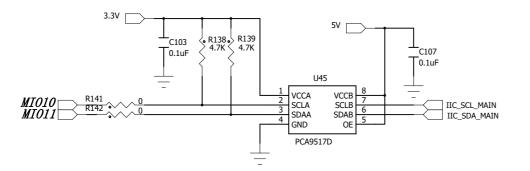
底图登记号





工艺

批准



					SOC						
					图号	14Y	F001				仪器平台
					图名	14Y	F001	_底板	•		
标记	更改单号		签字、	日期	板材	FR4					
设计		会签			板厚	1.6m	nm	铜厚	35um		北京中盛华旭
校对						阶段	设标记	1	版本	图纸	电子科技有限公司
审核		标审					S		A.2	А3	VCI INTEV

共 15页 第 14页

VSUNTEK

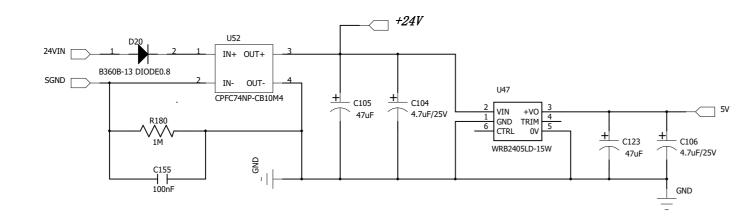
I2C HUB

第 14页

软盘编号

CAD

会签



描图 描校 旧底图登记号 底图登记号

					SOC						
					图号	14Y	'F001				仪器平台
					图名	14Y	'F001	_底板			
标记	更改单号		签字、	日期	板材	FR4					
设计		会签			板厚	1.6m	nm	铜厚	35um		北京中盛华旭
校对						阶段	设标记	Į.	版本	图纸	电子科技有限公司
审核		标审					S		A.2	A3	VSUNTEK
工艺		批准					共 1	.5 页 第	5 15页		VSUIVILIX